

ECALSデータ充足率 サプライヤアンケート結果と分析

バイヤ企業協議会
2009年2月06日

目次

1. アンケート方法
2. 未記入の理由に関する依頼内容
3. 充足率向上可能性が高いプロパティ
4. 充足率向上可能性が低いプロパティ
5. 充足率向上可能性が低いプロパティの理由
6. 理由に付加されたコメント
7. 理由、コメント等からの分析
8. まとめ

1. アンケート方法

1	調査依頼 サプライヤ	エリスネットにご参加のサプライヤ様で、2008.7に実施した「電子部品技術情報流通説明会」にご参加のサプライヤ様
		【一般電子部品】:抵抗、コンデンサ、インダクタ の情報を提供するサプライヤ様(19社)
		【半導体】:トランジスタ、ダイオード、IGBT、IPM の情報を提供するサプライヤ様(11社)
2	プロパティ	共通プロパティ
3	理由記入対象	充足率100%未満のプロパティ全て
4	依頼元等	バイヤ企業協議会からの委託を受け、エリスネットで依頼・集計

注:アンケートご回答について

- ・ご回答期限を短期(2週間)でお願いしました。
- ・その為、ご回答作成がデータ作成ご担当の方ではないことがあります。
- ・又、サプライヤ様を代表するご回答ではないこともあり得ます。

従って、個々のサプライヤ様のご回答ではなく、傾向として見て頂きたい。

2. 未記入の理由に関する依頼内容

未記入の理由が下記項目から選択できる場合は、項目のアルファベットを記入頂いた。

下記以外の理由の場合には、直接ご記入いただきました。

A	記入漏れ
B	データシートに記載がないため
C	方針として記入しない(可能でしたら、方針の理由を追記願います)
D	記入が難しい(可能でしたら、難しい理由を追記願います)
E	辞書改訂にコンテンツ更新が追いつかない(記述属性がMandatoryとなる以前に作成したコンテンツが存在)。今後追記は可能。
F	辞書改訂にコンテンツ更新が追いつかない(記述属性がMandatoryとなる以前に作成したコンテンツが存在)。今後追記の予定はない。
G	記入していなくてもバイヤで困らない情報と考えられる
H	他の属性で代用可能と考えられる

3. 充足率向上可能性が高いプロパティ

●:「未記入理由」の回答がA(記入漏れ)、E(今後追加可能)のプロパティ

一般電子部品

半導体

No	サプライヤ	パッケージ型名	表面実装	環境問題事項	製品発売日付	取付け高さTyp	取付け高さMax	本体長さTyp	本体長さMax	本体幅Typ	本体幅Max	本体高さTyp	本体高さMax	製品名	製品概要	用途	連絡先	カタログ情報	機能
1	A社																		
2	B社	●		●		●		●		●		●						●	
3	C社	●						●	●	●	●	●	●		●	●		●	●
4	D社				●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5	E社	●		●	●			●		●		●	●						●
6	F社		●					●		●		●	●						
7	G社			●	●			●		●		●	●						●
8	H社			●				●	●	●	●	●	●			●	●		
9	I社			●		●	●	●	●	●	●	●	●						
10	J社	●			●														
11	K社	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		
12	L社	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●			●			●
1	M社	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
2	N社					●	●	●	●	●	●	●	●						
3	O社		●												●	●	●		●
4	P社	●	●					●	●	●	●	●	●			●	●		
5	Q社		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
6	R社	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
7	S社		●												●	●	●	●	●
8	T社	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			

(注1) 一部の部品分類でA,Eの回答があれば●とした。

(注2) 複数理由の回答の場合、A,Eを含めば●とした。

(例 C社/本体寸法,製品概要,用途,データシート,機能:A,B、M社/製品名、用途:A&G、R社/パッケージ型名:A&Bなど)

(注3) 網掛けセルは全部品分類が充足率100%。

4. 充足率向上可能性が低いプロパティ

●:「未記入理由」の回答がA(記入漏れ)、E(今後追加可能)以外のプロパティ

一般電子部品

半導体

No	サプライヤ	パッケージ型名	表面実装	環境問題事項	製品発売日付	取付け高さTyp	取付け高さMax	本体長さTyp	本体長さMax	本体幅Typ	本体幅Max	本体高さTyp	本体高さMax	製品名	製品概要	用途	連絡先	カタログ情報	機能
1	A社	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				●
2	B社						●		●		●		●						
3	C社			●	●	●	●												
4	D社																		
5	E社			●		●	●												
6	F社	●		●	●	●	●		●		●				●	●		●	●
7	G社	●				●	●		●		●		●						
8	H社	●			●	●	●									●			
9	I社																		
10	J社					●	●		●		●		●						
11	K社																		
12	L社																		
1	M社			●	●												●		
2	N社	●	●	●	●									●	●	●	●		●
3	O社			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4	P社			●	●	●	●												
5	Q社	●		●	●														
6	R社	●		●	●														
7	S社		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
8	T社			●	●										●	●			

(注) 網掛けセル:一般電子部品、半導体各々でA,E以外の回答が特に多いプロパティ

5. 充足率向上可能性が低いプロパティの理由

(1) 一般電子部品

充足率向上の可能性 が低いプロパティ	データ未記入の理由 (回答社数:12社)		
		理由	サプライヤ数
取り付け高さmax	8社	1 データシートに記載がない	3
		2 バイヤが困らない	2
		3 他属性で代用可能	2
		4 記入が難しい	1
本体長さ,幅,高さのmax	6社	1 バイヤが困らない	2
		2 他属性で代用可能	2
		3 データシートに記載がない	1
		4 Typ,Maxどちらかが記入されていれば良い	1
パッケージ型名	4社	1 バイヤが困らない	1
		2 他属性で代用可能	1
		3 記入しない方針	1
		4 固定抵抗器ではパッケージ型名で表現しない	1
製品発売日付	4社	1 データシートに記載がない	2 (複数回答1含む)
		2 バイヤが困らない	1
		3 他属性で代用可能	1
		4 古い製品は無理	1
データシートの添付	1社	1 バイヤが困らない	1

5. 充足率向上可能性が低いプロパティの理由

(2) 半導体

充足率向上の可能性 が低いプロパティ	データ未記入の理由 (回答社数: 8社)		
		理由	サプライヤ数
製品発売日付	8社	1 データシートに記載がない	5
		2 記入が難しい	3 (複数回答1含む)
		3 記入しない方針	1
環境問題事項	8社	1 データシートに記載がない	5
		2 記入が難しい	2
		3 記入しない方針	1
取付け高さTyp、Max	3社	1 データシートに記載がない	1
		2 記入が難しい	1
		3 他属性で代用可能	1

6. 理由に付加されたコメント(抜粋)

(1) 一般電子部品

プロパティ	サプライヤ	理由	コメント
取付け高さtyp	A社	他	取付け方法が規定されていないので、基本的には入力不適。次回メンテ時に削除
	C社	他の属性で代用可能	製品高さtypではだめ？
取付け高さmax	C社	他の属性で代用可能	製品高さmaxではだめ？
パッケージ寸法全体	A社	他	「Typ」「Max」のいずれかが入力されていれば良い。合計で100%になれば基本的にはOK
パッケージ型名	A社	他	固定抵抗器では、通常パッケージ型名で表現しない(形状での表現が多い)
製品発売日付	A社	他	古い製品は無理と思う(技術部門の移転、移動等で書類紛失の場合あり)

6. 理由に付加されたコメント(抜粋)

(2) 半導体

プロパティ	サプライヤ	理由	コメント
環境問題事項	M社	データシートに記載がない	鉛フリーに関しては別途情報提供している
	P社	記入が難しい	マンドトリとの理解がまだ統一されていない、環境情報の変更が多い
	S社	記入が難しい	費用発生の為顧客要望により作成
	O社	他	(一部部品分類で)2006年頃以降記述
製品発売日付	S社	記入が難しい	費用発生の為顧客要望により作成
	T社	記入が難しい	特定が困難
取付け高さtyp	P社	他の属性で代用可能	製品高さtypではだめ?
	S社	記入なしでバイヤ困らない	データシートに記載
取付け高さmax	P社	他の属性で代用可能	製品高さmaxではだめ?
用途	M社	記入漏れ&記入なしでバイヤ困らない	製品による記述のばらつきが大きい
	P社	記入漏れ、データシートに記載がない	仕様書作成時期による
連絡先	M社	記入漏れ&記入なしでバイヤ困らない	現状、一つなので書いていません

7. 理由、コメント等からの分析

7.1 取付け高さ

(1) ECALS辞書定義

製品実装時に、取付け面(seating plane)から製品本体最高部までの高さ

(2) 現状定義の課題

① 面実装型PKG

現状定義では、

取付け面とリードフレームの間に入る半田ペーストを含めた寸法

と解釈される。

無論、半田ペースト量に関してはサプライヤの規定はない。

② 挿入型PKG

サプライヤはバイヤの基板のスルーホール径が分からないので、

取付け面に対してリードフレーム/スタンドオフのストップ位置がどこに来るのか正確には分からない。

③ 従って、辞書規定に

「製品実装時に、取付け面から」

が定義されていることが、記入を難しくしていると推定されます。

7. 理由、コメント等からの分析

(3) サプライヤが記入できるようにするための定義案

案1. “製品実装時”をどうしても入れる必要がある場合

面実装型パッケージでの適用に限定し、半田ペーストの厚さを考慮しなくてよい定義にする。

【例】

(面実装型の場合、)

製品実装時のリード最下面からパッケージ最上面までの長さ

案2. “製品実装時”を削除できる場合

挿入型と面実装型では定義を変える。

【例】

- ① 挿入実装型パッケージ：
スタンドオフ最下部からパッケージ最上部までの長さ
- ② 面実装型パッケージ：
リード最下面からパッケージ最上面までの長さ

7. 理由、コメント等からの分析

7.2 製品発売日付

(1) 課題

充足率アンケート調査依頼30社中、半導体全サプライヤ(11社)を含む20社が、充足率0%。

(2) 今後の検討事項

① バイヤニーズの確認

使い方は？、製品供給状態によっては必ずしも要らないのでは？ etc.

② ニーズ確認後、

- ・属性項目から削除
- ・記述属性のOptionへの変更
- ・条件を追加(例えば”製品供給状態”が”開発中”の品番に限定)

などについて検討を追加する予定。

7.3 パッケージ型名

(1) 課題

① 一般電子部品では、半導体のDIP,QFPのようなパッケージ名称が少ない。

② 一部の抵抗、コンデンサではサイズコードのプロパティが存在するため、サイズコードで代用出来るとの見解やパッケージ型名にもサイズコード記入のサプライヤがいる。

(2) 今後の検討課題

一般電子部品に対するバイヤニーズの調査、定義の検討(条件追加等)

8. まとめ

1. 今回のアンケートで、共通項目に関し傾向を捉える事ができた。
2. 今後バイヤ企業協議会でも、コンテンツを利用する側の視点で、記述が難しいプロパティにおける必要性・入力定義についての検討を進める。JEITA各辞書委員会、ECALS実用化専門委員会におかれましても何卒ご協力頂きたい。
3. アンケートのご回答を頂いたサプライヤ様へは、別途纏めた結果を送付させていただきます。またご回答内容に関し確認させて頂く可能性もありますので、引き続きご協力頂けます様宜しくお願い致します。